

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	财通证券、东北证券
时间	2024年5月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问公司目前晶圆代工厂项目进展情况如何？</b></p> <p>答：晶圆代工厂广芯微电子项目自2023年年底量产以来，产能不断提升，目前生产的产品主要包括：（1）广微集成的MOS场效应二极管，45-150V全系列百余款产品已完成开发并批量生产，广微集成已向广芯微电子下达超过11,000片的采购订单；（2）江苏丽隽半导体200-1,650V高压/超高压/特高压DMOS产品已完成验证，广芯微电子5月份收到其新下订单20,000多片；（3）熙芯微电子的高压BCD产品目前在进行工程批流片，预计近期完成验证并开始批量生产；（4）广芯微电子已于2024年5月顺利通过ISO9001和IATF16949汽车行业质量管理体系认证第二阶段审核，年底之前拿到ISO9001体系证书和IATF16949符合性声明，以实现车规级功率器件产品的生产供应。预计到今年年底，广芯微电子的晶圆代工产能将达到3万片/月。</p> <p><b>2、公司在功率半导体方面的投资很大，资金方面如何安排，后续是否还有其它投入？</b></p> <p>答：公司在功率半导体生产环节采用持续滚动投入的方式，在前一阶段投资建设的产能投产后，保证公司现金流安全稳定的前提下，然后再新增投资，持续滚动提升产能。公司通过该模式，已完成了在功率半导体产业链硅片原材料生产企业晶睿电子、晶圆代工厂广芯微电子、超薄背道代工厂芯微泰克等核心生产环节的投资建设，上述企业目前均已步入量产阶段并持续扩产。</p>

资金投入方面，各家公司除前期民德电子和当地政府基金投资，以及银行贷款、地方政府补贴外，晶睿电子和芯微泰克会通过市场化股权融资获取后续发展建设需要的资金，民德电子不会再新增投资，可能会在后续轮融资中少量转让老股并收回部分投资的现金；广芯微电子一期的固定资产投资已基本完成，目前主要任务是加快设备调试提升产能，同时，预计今年年底公司会完成对广芯微电子的控股，未来也会通过上市公司平台为广芯微电子发展提供更多的支持。后续，随着各家产能的不断提升，经营性现金也会持续流入，资金方面的压力会逐步减小。

上市公司未来几年在功率半导体领域预计不会有大的股权投资项目，主要是不断完善公司的 smart IDM 生态圈。

### 3、如何看今年功率半导体行业的市场行情？

答：功率半导体市场经过过去两年多对库存的消化，市场需求方面已出现好转迹象。比如，近两个月来公司硅片原材料厂晶睿电子的产能处于满产状态，上个月产值达到了自投产以来的新高；同时，市场上也看到，包括 MOSFET 在内的部分功率器件厂商的产品价格也有所提升。如后续订单需求及价格能持续提升，功率半导体市场也有望步入上升阶段。

### 4、公司 AiDC 业务目前的进展情况，今年的海外市场表现如何？

答：公司去年底将条码识别业务战略升级为 AiDC 事业部，并重点开拓 IVD（体外诊断设备行业）细分市场，今年已推出了数款应用于 IVD 行业的条码识别设备新品，目前新产品已在多家行业龙头企业进行测试验证，部分客户已开始批量采购，有望在今年获得明显进展。

公司条码识别业务今年一季度依旧保持稳健增长，收入较去年同期增长 13%，毛利率也有所提升；海外市场业务保持增长，销售额已占到条码业务的 6 成。

附件清单（如有）	无
日期	2024-5-29